# 05;09;12 Распространение межфазной *NS*-границы по высокотемпературной сверхпроводящей пленке, разогреваемой микроволновым излучением

#### © Н.А. Бузников<sup>1</sup>, А.А. Пухов<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Научно-исследовательский центр прикладных проблем электродинамики РАН, 127412 Москва, Россия <sup>2</sup>Институт высоких температур РАН, 127412 Москва, Россия

#### (Поступило в Редакцию 24 июня 1996 г.)

Теоретически исследована динамика *S*—*N*-перехода тонкой высокотемпературной сверхпроводящей пленки, разогреваемой микроволновым излучением. На основе решения двумерного нестационарного уравнения теплопроводности получена зависимость скорости распространения межфазной *NS*-границы от интенсивности излучения. Показано, что для вычисления этой зависимости важен учет двумерных эффектов, связанных с нелинейностью прогрева по толщине подложки, обратная сторона которой стабилизирована по температуре. Полученные результаты могут быть существенны при рассмотрении *S*—*N*-переходов сверхпроводящих устройств микроволнового диапазона.

## Введение

Переход высокотемпературной сверхпроводящей (ВТСП) пленки, расположенной на диэлектрической подложке, в нормальное состояние ( *S*-*N*-переход) под действием падающего электромагнитного излучения вызывает в последнее время значительный интерес в связи с созданием различных сверхпроводящих устройств микроволнового и инфракрасного диапазонов [1-3]. Резкое изменение электродинамических характеристик пленки при таком переключении обусловливает перспективность его использования в антеннах и резонаторах [4], экранах и фильтрах [1,2], переключателях и ограничителях мощности [5,6] и т.д. Тепловой механизм S-N-перехода подробно рассмотрен в [7,8]. Такой механизм позволяет качественно верно описать нелинейные эффекты, связанные с *S*-*N*-переключениями резонаторов [9,10], наблюдаемые экспериментально [11]. Резкое возрастание сопротивления пленки при превышении критической температуры Т<sub>с</sub> проводит к возникновению тепловой бистабильности. При заданном значении интенсивности падающего микроволнового излучения Р пленка может находиться в двух устойчивых однородных состояниях: сверхпроводящем (с температурой ниже критической) и нормальном (с температурой выше критической) [7–10].

S-N-переход происходит однородно по длине ВТСП пленки лишь в том случае, когда ее длина относительно мала. В обратном случае тепловое разрушение сверхпроводящего состояния, как правило, носит локальный характер. При локальном возникновении нормальной фазы S-N-переход осуществляется посредством распространения вдоль пленки температурной автоволны переключения. Такая автоволна представляет собой межфазную

*NS*-границу, переводящую образец из сверхпроводящего в нормальное состояние. Асимптотическое поведение *NS*-границы характеризуется постоянной скоростью ее распространения *v*. Зарождение, распространение, устойчивость таких автоволн, а также зависимость *v* от параметров достаточно подробно изучены для низкотемпературных композитных сверхпроводников с транспортным током [12,13].

Распространение NS-границы в тонких ВТСП пленках, разогреваемых микроволновым излучением или транспортным током, исследовалось экспериментально [14-17] и теоретически [10-18]. S-N-переход в системе пленка-подложка имеет целый ряд особенностей, которые не могут быть описаны в рамках стандартной одномерной теории распространения температурной автоволны [12,13]. Эти особенности связаны с существенной неоднородностью разогрева по сечению (тепловыделение происходит только в тонкой ВТСП пленке) [18] и с нелинейным распределением температуры по толщине подложки, обладающей высокой теплопроводностью и играющей роль "теплового резервуара" для ВТСП пленки. В [7–10] при анализе S-N-перехода ВТСП пленки под действием микроволнового излучения предполагалось, что температура линейно изменяется по толщине подложки (от температуры пленки T до температуры охладителя T<sub>0</sub>, при которой стабилизирована обратная сторона подложки). Это предположение позволяет решать задачу о распространении NS-границы в одномерном приближении, однако справедливо лишь в случае однородного по длине пленки S-N-перехода. Корректное описание распространения NS-границы в такой системе требует, вообще говоря, решения двумерного нестационарного уравнения теплопроводности [18].

#### Одномерное приближение

В одномерном приближении разогрев ВТСП пленки толщиной  $D_f$ , расположенной на диэлектрической подложке толщиной  $D_s$  (рис. 1), микроволновым излучением описывается уравнением теплопроводности [7–9]

$$\frac{C_s D_s}{2} \frac{\partial T}{\partial t} = k_s D_s \frac{\partial^2 T}{\partial X^2} - \frac{k_s}{D_s} (T - T_0) + Q(T) D_f, \quad (1)$$

где T — температура пленки;  $C_s$  и  $k_s$  — теплоемкость и теплопроводность подложки, обратная сторона которой стабилизирована по температуре  $T_0$ ,  $Q(T) = \varkappa(T) \cdot P$  — удельная мощность разогрева пленки, P — интенсивность падающего излучения,  $\varkappa(T)$  — коэффициент поглощения излучения пленкой.

В уравнении (1) учтено, что при типичном соотношении парамеров  $k_f D_s \gg k_s D_f$ ,  $C_f D_f \ll C_s D_s$ ,  $k_f \ll k_s$  ( $C_f$  и  $k_f$  — теплоемкость и теплопроводность пленки) температура пленки однородна по ее сечению, а эффективные теплоемкость и теплопроводность системы пленка-подложка определяются только свойствами подложки. В рамках одномерного приближения предполагается, что температура линейно убывает по толщине подложки. Основанием для этого предположения служит то обстоятельство, что именно такое распределение температуры устанавливается в подложке в случае однородного по длине ВТСП пленки *S*–*N*-перехода ( $\partial T / \partial X = 0$ ).

Температурная зависимость  $\varkappa(T)$  связана с резким изменением элекродинамических свойств ВТСП пленки при S - N-переходе и в рамках двухжидкостной модели сверхпроводника может быть описана соотношением [7]

$$\varkappa(T) = \varkappa_n \frac{(T_c - T_0)^2}{(T_c - T_0)^2 + \beta(T_c - T)^2 \eta(T_c - T)}.$$
 (2)

Здесь  $\varkappa_n = 4r/(2r+1)^2$  — коэффициент поглощения пленки в нормальном состоянии,  $r = (\varepsilon_0/\mu_0)^{1/2} (\rho/D_f)$ ,  $\rho$  — удельное сопротивление пленки в нормальном состоянии,  $\beta = [(f/f_0)(2r+1)]^{-2}$ , f — частота падающего излучения,  $f_0 = 2\rho(T_c - T_0)/\pi\mu_0\lambda^2T_c$ ,  $\lambda$  лондоновская глубина проникновения при  $T = T_0$ ,



**Рис. 1.** Схема распространения межфазной *NS*-границы по сверхпроводящей пленке на подложке. Обратная сторона подложки стабилизирована по температуре  $T_0$ .

 $\eta(x)$  — ступенчатая функция Хевисайда. Из формулы (2) следует, что при  $f \ll f_0$  температурная нелинейность  $\varkappa(T)$  ярко выражена, и это приводит к микроволновой бистабильности пленки. При типичных значениях параметров Y–Ba–Cu–O пленки в области азотных температур  $T_0 \cong 77 \,\mathrm{K}, T_c \cong 90 \,\mathrm{K}, \rho \cong 5 \cdot 10^{-7} \,\Omega \cdot\mathrm{m}, \lambda \cong 10^{-7} \,\mathrm{m}$  получаем  $f_0 \approx 3 \cdot 10^{12} \,\mathrm{Hz}$ . Таким образом, в микроволновом диапазоне ( $f \ll f_0$ ) температурную зависимость  $\varkappa(T)$  можно аппроксимировать ступенчатой функцией

$$\varkappa(T) = \varkappa_n \eta(T - T_c). \tag{3}$$

Температуры однородных стационарных состояний, в которых может находиться ВТСП пленка на термостабилизированной подложке, определяются из условия равенства тепловыделения в пленке отводу тепла в подложку. Из (1) при  $\partial T/\partial t = \partial^2 T/\partial X^2 = 0$  получаем уравнение теплового баланса

$$\varkappa(T) \cdot P = \frac{k_s}{D_f D_s} (T - T_0), \tag{4}$$

решениями которого являются температуры стационарного сверхпроводящего ( $T_1 = T_0$ ) и нормального ( $T_2 = T_0 + \varkappa_n PD_f D_s / k_s$ ) состояний. *NS*-граница представляет собой автоволну переключения между этими двумя устойчивыми состояниями ВТСП пленки.

Полагая для простоты, что зависимостями теплоемкости и теплопроводности подложки от температуры можно пренебречь, и вводя безразмерные параметры

$$x = \frac{X}{D_s}, \quad \tau = \frac{t}{C_s D_s^2 / k_s},$$
$$\Theta = \frac{T - T_0}{T_c - T_0}, \quad p = P \frac{\varkappa_n D_f D_s}{k_s (T_c - T_0)}, \quad (5)$$

представим уравнение (1) в виде

$$\frac{1}{2}\frac{\partial\Theta}{\partial\tau} = \frac{\partial^2\Theta}{\partial x^2} - \Theta + p\eta(\Theta - 1).$$
(6)

Распространяющаяся NS-граница описывается автомодельным решением уравнения (6) вида  $\Theta(x, \tau) = \Theta(x + u\tau)$ , удовлетворяющего граничным условиям  $\Theta(-\infty) = 0$  и  $\Theta(+\infty) = p$ . Здесь  $u = v/v_h$ ,  $v_h = k_s / C_s D_s$  — характерная "тепловая" скорость NS-границы. Отметим, что v<sub>h</sub> определяется только свойствами подложки и при характерных значениях параметров для подложки MgO ( $C_s \cong 5 \cdot 10^5 \, \text{J} \cdot \text{m}^{-3} \cdot \text{K}^{-1}$ ,  $k_s \cong 350 \,\mathrm{W} \cdot \mathrm{m}^{-1} \cdot \mathrm{K}^{-1})$ или Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ( $C_s \cong 4 \cdot 10^5 \,\mathrm{J} \cdot \mathrm{m}^{-3} \cdot \mathrm{K}^{-1}$ ,  $k_s \cong 650 \, \mathrm{W} \cdot \mathrm{m}^{-1} \cdot \mathrm{K}^{-1}$ ) толщиной  $D_s \cong 10^{-3} \, \mathrm{m}$  получаем  $v_h \approx 1 \text{ m/s}$ . Безразмерная скорость распространения NSграницы и зависит от значения управляющего параметра р, который является отношением разогрева пленки в нормальном состоянии к характерному теплоотводу в подложку.

Уравнение (6) является кусочно-линейным и может быть решено аналитически [12,13], что позволяет получить для скорости распространения *NS*-границы выражение

$$u = 2\frac{p-2}{\sqrt{p-1}}.$$
 (7)

Формула (7) определяет зависимость u(p) во всем интервале бистабильности 1 . Нормальная фаза вытесняет сверхпроводящую <math>(u > 0), если интенсивность излучения превышает пороговое значение  $p_p = 2$  ("интенсивность распространения"). Из (7) получаем, что  $u \cong 2 \cdot (p-2)$  при  $p \cong p_p$  и  $u \cong 2p^{1/2}$  при  $p \gg p_p$ . В интервале 1 происходит вытеснение нормальной фазы <math>(u < 0) и сверхпроводимость в пленке восстанавливается.

## Двумерное приближение

Выше отмечалось, что одномерное приближение справедливо при линейном изменении температуры по толщине подложки. Однако такая ситуация имеет место только вдали от фронта *NS*-границы. Более корректное описание распространения *NS*-границы требует учета двумерности задачи. Для этого пленку и подложку следует рассматривать отдельно как две взаимодействующие тепловые подсистемы. При  $k_f D_s \gg k_s D_f$  распределение температуры вдоль пленки удовлетворяет одномерному уравнению теплопроводности

$$C_f \frac{\partial T}{\partial t} = k_f \frac{\partial^2 T}{\partial X^2} + \theta(T) + \frac{k_s}{D_f} \frac{\partial T}{\partial Y}, \quad 0 < Y < D_f. \quad (8)$$

Последний член в уравнении (8) соответствует отводу тепла из пленки в подложку. Распределение температуры в подложке описывается двумерным уравнением теплопроводности

$$C_s \frac{\partial T}{\partial t} = k_s \frac{\partial^2 T}{\partial X^2} + k_s \frac{\partial^2 T}{\partial Y^2}, \quad D_f < Y < D_f + D_s.$$
(9)

С учетом  $D_f \ll D_s$  и  $Q(T) = P \varkappa_n \eta(T - T_c)$  и (5) представим уравнения (8) и (9) в безразмерном виде

$$C\frac{\partial\Theta}{\partial\tau} = K\frac{\partial^2\Theta}{\partial x^2} + p\eta(\Theta - 1) + \frac{\partial\Theta}{\partial y}, \quad y = 0, \quad (10)$$

$$\frac{\partial \Theta}{\partial \tau} = \frac{\partial^2 \Theta}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Theta}{\partial y^2}, \quad 0 < y < 1, \tag{11}$$

где  $C = C_f D_f / C_s D_s$ ,  $K = k_f D_f / k_s D_s$ ,  $y = Y / D_s$ .

Уравнение (11) необходимо дополнить граничным условием при y = 1. Учитывая, что со стороны, противоположной пленке, подложка стабилизирована по температуре  $T = T_0$ , имеем

$$\Theta = 0, \quad y = 1. \tag{12}$$

Таким образом, динамика изменения температуры в системе пленка-подложка описывается двумерным нестационарным уравнением теплопроводности (11) с граничными условиями (10) и (12). Простые оценки показывают, что для Y-Ba-Cu-O пленок ( $C_f \cong 9 \cdot 10^5 \, J \cdot m^{-3} \cdot K^{-1}$ ,  $k_f \cong 5 \, W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1}$ ) толщиной  $D_f \cong 10^{-7} - 10^{-6}$  m, расположенных на подложках MgO или Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> толщиной  $D_s \cong 10^{-4} - 10^{-3}$  m, параметры *C* 



**Рис. 2.** Зависимость скорости распространения *NS*-границы от интенсивности излучения. *I* — расчет по формуле (7), *2* — расчет по формуле (15).

и *К* малы,  $C \approx 10^{-3}$ ,  $K \approx 10^{-5}$ , поэтому первыми двумя членами в (10) можно пренебречь.

Распределение температуры в подложке в движущейся вместе с *NS*-границей системе координат ( $z = x + u\tau$ ) удовлетворяет уравнению

$$\frac{\partial^2 \Theta}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 \Theta}{\partial y^2} - u \frac{\partial \Theta}{\partial z} = 0.$$
(13)

Вдали от фронта *NS*-границы ВТСП пленка находится в однородных состояниях  $\Theta(z, 0) = 0$  при  $z \to -\infty$  и  $\Theta(z, 0) = p$  при  $z \to \infty$ , а профиль температуры в подложке является линейным. Выберем начало координат таким образом, чтобы выполнялось условие  $\Theta(0, 0) = 1$ (это всегда возможно вследствие трансляционной инвариантности уравнения (13)). Тогда граничные условия к (13), которые определяются выражениями (10) и (12), с учетом  $C \ll 1$ ,  $K \ll 1$  можно записать в виде

$$\left. \frac{\partial \Theta}{\partial y} \right|_{y=0} = -p \cdot \eta(z), \quad \Theta \Big|_{y=1} = 0.$$
 (14)

Распределение температуры в системе пленкаподложка определяется решением смешанной задачи Дирихле–Неймана в полосе 0 < y < 1 для двумерного уравнения (13) с граничными условиями (14), которая может быть решена методом резделения переменных (см. Приложение). Это обстоятельство позволяет получить для скорости распространения *NS*-границы выражение

$$\frac{p-2}{2p} = u \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{\lambda_k^2 \sqrt{u^2 + 4\lambda_k^2}},$$
 (15)

где  $\lambda_k = \pi (2k+1)/2.$ 

Из формулы (15) следует, что скорость межфазной NSграницы u равна нулю при "интенсивности распространения"  $p_p = 2$ . Из (15) удобно получить приближенные выражения для зависимости u(p) при  $p \cong p_p$  и при  $p \gg p_p$ . При  $p \cong p_p$  ( $u \ll 1$ ) имеем

$$u \cong \frac{\pi}{14 \cdot \zeta(3)} (p-2) \approx 1.84 (p-2),$$
 (16)

где  $\zeta(x)$  — дзета-функция Римана.

С помощью формулы суммирования Эйлера–Маклорена при  $p \gg p_p \ (u \gg 1)$  из (15) получаем

$$u \cong (2/\pi)p. \tag{17}$$

В области малых скоростей распространения межфазной *NS*-границы ( $u \le 1$ ) формулы (7) и (15) практически совпадают, а при  $u \ge 1$  зависимость u(p) качественно изменяется (рис. 2). Это отличие связано с тем, что при больших скоростях распространения межфазной границы ( $u \ge 1$ ) подложка не успевает прогреваться за время прохождения фронта *NS*-границы.

Решение уравнения (13) с граничными условиями (14) позволяет также получить оценку для ширины фронта *NS*-границы *L* (см. Приложение)

$$L = \frac{4D_s}{\pi^2} \sqrt{u^2 + \pi^2}.$$
 (18)

Из (18) следует, что  $L \cong 4D_s/\pi^2 \sim D_s$  при  $p \cong p_p$ . Таким образом, для ВТСП пленки, расположенной на термостабилизированной подложке, характерный масштаб фронта *NS*-границы определяется толщиной подложки  $L \sim D_s$ .

# ВТСП пленка, разогреваемая транспортным током

Рассмотрим теперь распространение *NS*-границы по ВТСП пленке с транспортным током. Возникновение тепловой бистабильности, наблюдавшееся экспериментально [14–17], в этом случае связано с джоулевым саморазогревом пленки. Распределение температуры в системе пленка–подложка описывается уравнением (1) в одномерном приближении и уравнениями (8), (9) в двумерном приближении. Удельная мощность разогрева пленки транспортным током описывается выражением [12,13]

$$Q(T) = \rho j^2 \cdot \eta (T - T_r), \qquad (19)$$

где j — плотность транспортного тока,  $T_r = T_0 + (1 - j/j_c)(T_c - T_0)$  — температура резистивного перехода,  $j_c$  — критическая плотность тока при  $T = T_0$ .

Из (1), (8), (9) и (19) следует, что безразмерная скорость *NS*-границы в пленке, разогреваемой током, зависит только от одного безразмерного параметра  $\xi = k_s(T_r - T_0)/\rho j^2 D_f D_s$ , а выражение для *и* может быть получено из (7) (одномерное приближение) и (15)



**Рис. 3.** Зависимость скорости распространения *NS*-границы от плотности транспортного тока. 1 -расчет по формуле (20), 2 -расчет по формуле (21);  $\alpha = 5$ .

(двумерное приближение) при помощи замены  $p \to 1/\xi$ . Таким образом, для *и* имеем в одномерном приближении

$$u = 2 \frac{\alpha i^2 + 2i - 2}{\sqrt{(\alpha i^2 + i - 1)(1 - i)}}$$
(20)

и в двумерном приближении

$$\frac{\alpha i^2 + 2i - 2}{\alpha i^2} = u \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{\lambda_k^2 \sqrt{u^2 + 4\lambda_k^2}}.$$
 (21)

Здесь  $\alpha = \rho j_c^2 D_f D_s / k_s (T_c - T_0)$  — эффективный параметр Стекли системы пленка-подложка,  $i = j/j_c$ . Из (20) и (21) следует, что *NS*-граница покоится при "токе распространения"  $j_p = j_c [(1 + 2\alpha)^{1/2} - 1]/\alpha$ . При типичных значениях параметров пленки и подложки, приведенных выше, и  $j_c \simeq 10^{10} \text{ A} \cdot \text{m}^{-2}$  получаем  $\alpha \approx 1-10$ , т.е. для ВТСП пленки величина  $j_p$  сравнима с  $j_c$ . Вблизи тока распространения  $j \cong j_p$  ( $u \ll 1$ ) из (21) получаем  $u \simeq [2\pi^3/7\zeta(3)](j - j_p)/j_c \approx 7.36(j - j_p)j_c$ , что лишь незначительно отличается от выражения  $u \simeq 8(j-j_p)/j_c$ , следующего из формулы (20). Существенное различие возникает при  $j \simeq j_c$  ( $u \gg 1$ ): в одномерном приближении  $u \simeq 2[\alpha i^2/(1-i)]^{1/2}$ , тогда как из (21) следует  $u \simeq (2/\pi)\alpha i^2/(1-i)$  (рис. 3).

#### Заключение

В работе исследована динамика *S*–*N*-перехода в ВТСП пленке на термостабилизированной подложке, вызванного разогревом микроволновым излучением или транспортным током. Рассматриваемая система характеризуется существенной неоднородностью разогрева по сечению и нелинейным распределением температуры по толщине подложки, обладающей высокой теплопроводностью и играющей роль "теплового резервуара" для ВТСП пленки. Эти особенности приводят к тому, что динамика теплового перехода не может быть корректно описана в рамках одномерной теории распространения *NS*-границы [12,13].

На основе решения двумерного нестационарного уравнения теплопроводности получена зависимость v(P). В области малых скоростей межфазной NS-границы  $v \leq k_s C_s^{-1} D_s^{-1} (P \cong P_p = 2k_s (T_c - T_0) / \varkappa_n D_f D_s)$ эта зависимость практически совпадает с зависимостью v(P), полученной в рамках одномерного приближения. При "быстром" распространении межфазной *NS*-границы  $v \ge k_s C_s^{-1} D_s^{-1} (P \gg P_p)$  зависимость *v*(*P*) качественно изменяется: в двумерном приближении  $v \propto P$ , тогда как из одномерного приближения следует, что  $v \propto P^{1/2}$ . Это обстоятельство связано с тем, что при  $v \ge k_s C_s^{-1} D_s^{-1}$  подложка не успевает прогреваться за время прохождения фронта NS-границы и распределение температуры в ней существенно отличается от линейного. Аналогичная особенность распространения NS-границы имеет место и при разогреве пленки транспортным током.

В заключение отметим, что возможна другая ситуация, когда ВТСП пленка расположена на подложке, целиком погруженной в жидкий азот [16,17]. В этом случае, как показывают простые оценки, параметр Биосистемы пленка-подложка мал,  $hD_s/k_s \ll 1$ (коэффициент теплоотвода в азот  $h \approx 10^4 \,\mathrm{W \cdot m^{-2} K^{-1}}$ ,  $D_s \approx 10^{-3} \,\mathrm{m}$ ,  $k_s \approx 10^2 \,\mathrm{W \cdot m^{-1} K^{-1}}$ ) и температура практически не изменяется по толщине подложки, следовательно, S-N-переход может быть удовлетворительно описан в рамках одномерной теории распространения *NS*-границы [16,17].

Работа выполнена при поддержке Научного совета по проблеме ВТСП (проект № 93027) и Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 96-02-18949).

# Приложение

Будем искать решение задачи (13), (14) методом разделения переменных, который позволяет представить  $\Theta(z, y)$  в виде ряда Фурье

$$\Theta(z, y) = p\eta(z)(1-y) + \sum_{k=0}^{\infty} f_k(z) \cos(\lambda_k y), \quad (\Pi 1)$$

где  $\lambda_k = \pi (2k+1)/2$ ,  $f_k(z)$  — неизвестная функция.

Выражение (П1) представляет собой общее решение уравнения (13), обеспечивающее выполнение граничных условий (14). Подставляя (П1) в (13) и решая получающееся обыкновенное дифференциальное уравнение, для функции  $f_k(z)$  получаем

$$f_k(z) = \begin{cases} A_k \exp\{\left(\frac{u}{2} + \mu_k\right) z\}, & z < 0, \\ B_k \exp\{\left(\frac{u}{2} - \mu_k\right) z\}, & z > 0, \end{cases}$$
(II2)

где  $A_k$ ,  $B_k$  — численные коэффициенты;  $\mu_k = (u^2/4 + \lambda_k^2)^{1/2}$ .

Используя разложение

$$1-y=2\sum_{k=0}^{\infty}\lambda_k^2\cos(\lambda_k y),$$

из (П1) и (П2) имеем

$$\Theta(z, y) = \begin{cases} \sum_{k=0}^{\infty} A_k \exp\left\{\left(\frac{u}{2} + \mu_k\right)z\right\}\cos(\lambda_k y), & z < 0, \\ \sum_{k=0}^{\infty} \left[\frac{2p}{\lambda_k^2} + B_k \exp\left\{\left(\frac{u}{2} - \mu_k\right)z\right\}\right]\cos(\lambda_k y), & z > 0. \end{cases}$$
(II3)

Коэффициенты  $A_k$  и  $B_k$  определяются из условия непрерывности температуры и ее производной по z на прямой z = 0. Опуская промежуточные вычисления, приведем выражение для распределения температуры в подложке

$$\Theta(z, y) = p$$

$$\times \begin{cases} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{\lambda_k^2} \left(1 - \frac{u}{2\mu_k}\right) \\ & \times \exp\left\{\left(\frac{u}{2} + \mu_k\right)z\right\}\cos(\lambda_k y), \quad z < 0, \\ & \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{\lambda_k^2} \left[2 - \left(1 + \frac{u}{2\mu_k}\right) \\ & \times \exp\left\{\left(\frac{u}{2} - \mu_k\right)z\right\}\right]\cos(\lambda_k y), \quad z > 0. \end{cases}$$
(II4)

Учитывая, что начало координат выбрано таким образом, что  $\Theta(0,0)=1,$  из  $(\Pi 4)$  получаем

$$\frac{p-2}{2p} = u \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{\lambda_k^2 \sqrt{u^2 + 4\lambda_k^2}}.$$
 (II5)

Из формулы (П4) можно получить также оценку для ширины фронта *NS*-границы, которая, очевидно, определяется наименьшим значением  $\mu_k$ :  $\mu_0 = (u^2 + \pi^2)^{1/2}/2$ . Окончательно для ширины фронта  $L = D_s/(\mu_0 + u/2) + D_s/(\mu_0 - u/2)$  имеем

$$L = \frac{4D_s}{\pi^2} \sqrt{u^2 + \pi^2}.$$
 (II6)

# Список литературы

- [1] Вендик О.Г., Ковалевич Л., Митрофанов А.П. и др. // СФХТ. 1990. Т. З. № 10(1). С. 2133–2142.
- [2] Likharev K.K. // Supercond. Sci. Technol. 1990. Vol. 3. N 7. P. 325–337.
- [3] Newman N., Lyons W.G. // J. Supercond. 1993. Vol. 6. N 2.
   P. 119–159.
- [4] Hansen R.C. IEEE Trans. Aerosp. and Electron. Syst. 1990. Vol. 26. N 2. P. 345–355.
- [5] Вендик О.Г., Карпюк А., Колесов С.Г., Попов А.Ю. // СФХТ. 1990. Т. З. № 10(1). С. 2161–2169.

- [6] Гайдуков М.М., Козырев А.Б., Ковалевич Л. н др. // СФХТ. 1990. Т. 3. № 10(1). С. 2170–2174.
- [7] Жаров А.А., Коротков А.Л., Резник А.Н. // СФХТ. 1992.
   Т. 5. № 3. С. 419–422.
- [8] Zharov A.A., Korotkov A.L., Reznik A.N. // Supercond. Sci. Technol. 1992. Vol. 5. N 3. P. 104–106.
- [9] Резник А.Н., Смирнов А.И., Чернобровцева М.Д. // СФХТ. 1993. Т. 6. № 2. С. 242–251.
- [10] Reznik A.N., Zharov A.A., Chernobrovtseva M.D. // IEEE Trans. Appl. Supercond. 1995. Vol. 5. N 2(III). P. 2579–2582.
- [11] Portis A.M., Chaloupka H., Jeck M. et al. // Supercond. Sci. Technol. 1991. Vol. 4. N 3. P. 436–438.
- [12] Уилсон М. Сверхпроводящие магниты. М.: Мир, 1985. 407 с.
- [13] Гуревич А.Вл., Минц Р.Г., Рахманов А.Л. Физика композитных сверхпроводников. М.: Наука, 1987. 240 с.
- [14] Скоков В.Н., Коверда В.П. // СФХТ. 1993. Т. 6. № 8. С. 1646–1651.
- [15] Scokov V.N., Koverda V.P. // Phys. Stat. Sol. (a). 1994. Vol. 142. N 1. P. 193–199.
- [16] Луцет М.О. // Письма в ЖТФ. 1994. Т. 20. Вып. 18. С. 7–10.
- [17] Луцет М.О., Климов С.В. // СФХТ. 1994. Т. 7. № 8–9. С. 1372–1381.
- [18] Levillain C., Manuel P., Therond P.G. // Cryogenics. 1994. Vol. 34. N 1. P. 69–75.